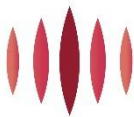


## 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YT\_ZQSWB\_2026\_5\_1

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 公司现场接待 <input checked="" type="checkbox"/> 电话接待 <input checked="" type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	东吴证券、广发基金、泰康资产、华安证券、华鑫证券、乘是资产、昱奕资产、淡水泉（北京）投资、红骅投资、银河基金、玖鹏资产、弘毅远方基金、富安达基金、国联安基金、碧云资本、国华兴益资管、万霁资管、仙人掌投资、湘财基金、Forward Edge Investment、长江证券资管、山西证券资管、中港融鑫资管、农银汇理基金、大朴资产、朱雀基金、上海证券自营、中邮证券、汇添富基金、天风证券、博普资产、中欧博瑞基金、鹏华基金、长城基金、博时基金
日期时间	2026年4月29日-5月8日
地点	上海市、深圳市
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书：黄婕；资本运营主管：张瑶
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</b></p> <p><b>一、介绍环节</b></p> <p>首先就公司2025年年报和2026年一季报情况做简要说明。</p> <p>2025年度，公司整体实现营收61,659.55万元，较上年同期增加55.62%；实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入61,551.28万元，较上年同期增加55.42%，主要系2.5G网通以太网物理层芯片、车载以太网物理层芯片、单口及多口网通以太网物理层芯片等市场需求旺盛、市场拓展情况良好、销售规模实现放量增长所致。</p> <p>季度来看，2025年以来，公司单季营收逐季走高，2025年四季度单季实</p>



现营收 22,893.62 万元，单季同比增速约为 75.89%，环比增速约为 38.05%，四季度单季营收达到历年单季最高营收。

分产品看，网通类产品实现营收约 5.46 亿元，营收同比增长 40.08%；车载类产品实现营收 0.70 亿元，营收同比增长 1,331.91%，车载类产品成为公司最新的营收增长极。

2025 年度，公司研发费用为 31,507.16 万元，同比增长 7.31%；研发费用占当期营业收入比例为 51.10%，伴随营收规模的迅速增长，研发费用率同比有所下降，公司在不降低研发投入前提下持续降低研发费用率，向高效率研发转换，为实现尽快扭亏奠定基础。

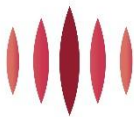
2026 年 Q1 实现营收约 1.42 亿元，较上年同期增长 74.83%，研发费用 0.73 亿，研发费用率为 51.65%，同比降低 38.74 个百分点。

总体而言，公司已经进入稳健发展的关键期，报告期内均保持了营收同比增长趋势。公司产品线中，网通类产品作为营收基本盘稳固，在国内企业中具有明显的先发优势并持续夯实，车载产品线快速成长，有望贡献第二增长曲线。

## 二、互动交流环节

### 1、公司本次再融资主要布局哪些产品，后续时间表是怎样的。

答：公司近期发布了再融资预案，本次再融资拟融资规模约 13.61 亿元，除补流资金外，主要用于两个项目，分别是面向汽车场景的新一代高速通信芯片研发及产业化项目，以及面向数据中心场景的新一代高速互连网络通信方案研发项目。面向汽车场景项目旨在持续推进更高速的车载 PHY 芯片、TSN Switch 芯片和车载 SerDes 芯片的研发和产业化项目，丰富公司车载产品组合。面向数据中心场景项目则希望聚焦于数据中心组网中底层支撑技术中的高速互连和网络接口技术的研发，侧重于对高速 SerDes 等高速互连技术的研发，核心是对底层高速通信技术的研发和迭代，本质是聚焦底层技术的研究，具体产品形态需要公司内部预研后遵循



内部制度和流程才能确定，距离产品化尚存在距离。项目预计实施周期四年，项目进度和项目成果都会存在不确定性。且目前该再融资项目仅仅处于预案阶段，后续仍需经历股东会审议、交易所审核及证监会注册等流程，若后续能够注册获批，公司会在有效期内随行就市进行发行，需要提醒大家注意投资风险。

## 2、关于数据中心场景的新一代高速互连网络通信方案研发项目目前进度如何，技术储备和相关团队来自哪里？

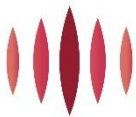
答：目前该项目仍处于前期规划阶段，公司深耕高速有线通信芯片领域多年，围绕高速有线通信构建了完整的技术体系。在核心技术层面，公司自主研发的高性能 SerDes 设计技术、高性能 ADC 设计技术、低抖动锁相环设计技术等底层技术，构成了公司的核心竞争壁垒，在底层通信架构与信号处理逻辑等维度可有效复用公司现有技术资产，但是与高速数据中心场景中所需的传输技术仍然存在区别，公司尚需时间进行深入的技术研判与方案论证。在团队布局方面，公司则保持开放态度，会积极整合内外部的优质资源，以保障项目的顺利推进。

## 3、公司未来营收预期是什么？什么时候扭亏？

答：公司近期发布了新一期的股权激励草案，以 2025 年营收 6.17 亿元为基数，设定 2026—2028 年营收增长率目标分别为 30%、60%、90%，对应 2026 年目标约 8 亿元。目前公司仍处于亏损状态，主要因研发费用等费用率高于毛利率。公司将通过调整各项费用，依托营收的快速增长来降低各项费用率，力争 2026 年第四季度实现单季扭亏。

## 4、公司对于股权激励的规划是什么？

答：股权激励作为科创公司吸引和留住人才的重要手段，可以充分调动核心团队积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司会考虑将股权激励作为长效激励机制的一部分，未来计划每 1 至 2 年开展一次股权激励。



	<p><b>5、 公司产品毛利率情况怎么样，有没有涨价计划?</b></p> <p>答：2025 年度公司整体毛利率为 43.54%，2025 年和 2026 年 Q1 单季度毛利率在 40%~45%之间波动，总体保持稳定。分产品来看，2025 年度网通类产品毛利率为 45.25%、车载类产品毛利率为 28.98%，车载类产品较低主要受汽车价格竞争激烈间接影响和仍未大规模批量上量所致。公司将积极进行成本管控，力争将公司整体毛利率维持在 40%左右。目前产品暂无涨价计划。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>